

第 11 回 有機/無機接合研究委員会

日時：2021年 10月 20日（水）13:00～16:05
オンライン開催

プログラム

12:45～受付開始

司会 渡辺 潤（OKIネクステック(株)）

13:00～13:05 委員会議事

13:05～13:45

「半導体の多機能化に貢献する粘着・接着フィルム材料」（40分）

○市川 功（リンテック(株)）

13:45～13:50 休憩・準備

13:50～14:30

「金属ナノワイヤを用いた透明電極シートの開発と生体計測応用」（40分）

○荒木 徹平（大阪大学）

14:30～14:40 休憩・準備

司会 西川 宏（大阪大学）

14:40～15:20

「パワーモジュール実装信頼性に対する封止樹脂物性の影響」（40分）

○伊勢谷 健司（(株)先端力学シミュレーション研究所）

15:20～15:25 休憩・準備

15:25～16:05

「レーザー加工を用いたモールド樹脂の密着性評価手法」（40分）

○岩井 貴雅（三菱電機(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 有機/無機接合研究委員会